

虎門科技第 21 屆 CAE 應用年會徵求【論文投稿·案例發表】

歡迎各界投稿，向世界展示您的研究與發展成果

自 1992 年以來，每年都會盛大舉辦的虎門科技 CAE 用戶大會活動即將於 2012 年再次展開，也是您向全球展現您在科學研究與產業研發成果之最佳時機。我們誠摯的邀約您發表關於 ANSYS/FLUENT/CFX/IcePak/Polyflow/Maxwell/Simplorer&Recurdyn/Chemkin/Ensign t 等應用之論文。近期將在虎門網站公佈各論文的主題及主講者資訊，歡迎對各議題有興趣的人員來參加。如果您目前還不是 ANSYS 相關軟體的使用者，參加這個年會，能讓您發覺 ANSYS 流，固，磁，多重物理耦合的卓越能力。如果您是 ANSYS 的使用者，參加每年一次的會議，您更不會錯過與台灣各界 ANSYS CAE 的使用者在應用面技術交流的機會。詳情請參考虎門科技每年的 CAE 用戶大會論文發表。

<http://com.cadmen.com.tw/tr/2011conference/cae2011/web/paper.html>

誠徵與 ANSYS CAE 相關的學術研究與產業界實務論文。特別歡迎注重於如何應用 ANSYS CAE 各項功能的文章。被評審合格的論文將於用戶大會中發表並給予鼓勵獎金。英文版論文也將轉送 ANSYS 總部，以期刊登於其全球發行的 ANSYS Advantage Magazine.

用戶大會的宗旨

- 使用者交流聯誼讓虎門代理軟體的使用者有互相交流的機會
- 使用者可更加認識工程模擬系統的卓越效能
- 提供產業最新的資訊
- 與產官學研界的各位先進以及虎門科技技術團隊直接接觸溝通

徵文領域

- 機械固體
- 熱流暨能源
- 半導體與其他
- 其它工程技術相關

徵求項目

1. 【論文 Call for Papers】

誠徵應用虎門科技支援服務的 CAE/CFD/Electromagnetics 軟體系統-
ANSYS/FLUENT/CFX/Icepak/Polyflow/Maxwell/Simplorer/Recurdyn/
Chemkin/Ensign 在學術研究與產業界研發實務應用之相關論文。

◎ Key Date

中英文題目及摘要：10月12日前 《題目-摘要格式下載》

論文全文定稿：10月26日前 《論文格式下載》 (檔案大小請在 20MB 以下)

◎ 說明

A) 邀稿對象：不限台灣地區，歡迎中國大陸、日本、新加坡等國內外各界

人士投稿，若您曾經投稿過國內外之論文，我們也亦歡迎您

B) 評審為『佳作』之論文將頒發獎狀一紙，全文收錄在論文光碟中。

C) 我們僅安排部份論文於年會中進行口頭發表。

D) 歡迎提供英文版本，我們將提供給原廠總公司留存。

2. 【案例發表 Call for Presentations】

案例發表只需提供簡報電子檔即可，不需繳交論文。

◎ Key Date

1. 發表中英文題目、發表人資料及 30 頁內的投影片：10月12日前

《提交資料格式下載》

(30 頁內的投影片為製作論文集用，請投稿者斟酌內容後提供)

(如無法準時提供，請於 10 月 26 日前連同完整簡報資料電子檔一併提供)

2. 簡報資料電子檔：10 月 26 日前(PPT 檔，20MB 以內)

※恕不接受在校學生發表。

◎說明

A)邀稿對象：不限台灣地區，歡迎中國大陸、日本、新加坡等國內外產學研界專家、教授蒞臨發表。

B)我們將印製論文集留存您的智慧與成就，並頒贈感謝狀與獎金。

◎會議資訊：

會議時間：11 月 23 日(五)

會議地點：台北市，南港展覽館 4F

《投稿、發表可擇一或兩項都報名參與》

以上資料或相關問題請 email: mkt@cadmen.com

或電洽 02-29567575 分機 212 張先生